

BQ27Z561 适用于 1 节串联电芯锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案

1 特性

- 支持低至 $1\text{m}\Omega$ 的高侧和低侧电流检测电阻
- SHA-256 认证响应器，用于提高电池包安全性
- 两个独立的 ADC
 - 支持电流和电压同步采样
 - 高精度库仑计数器，输入偏移误差： $< 1\mu\text{V}$ (典型值)
- 低电压运行范围：2V
- 支持电池包侧电量监测
- 宽量程电流应用：1mA 至 $> 5\text{A}$
- 有效高电平或低电平中断引脚
- 节能模式 (典型电池包运行范围条件)
 - 典型睡眠模式： $< 11\mu\text{A}$
 - 典型深度睡眠模式： $< 9\mu\text{A}$
 - 典型关断模式： $< 1.9\mu\text{A}$
- 内部和外部温度检测功能
- 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I²C 总线通信接口
- 用于与主机通信的 HDQ 单线接口
- 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)

2 应用

- 智能手机
- 数码相机与数码摄像机
- 平板电脑计算
- 便携式和可穿戴保健设备以及便携式音频设备

3 说明

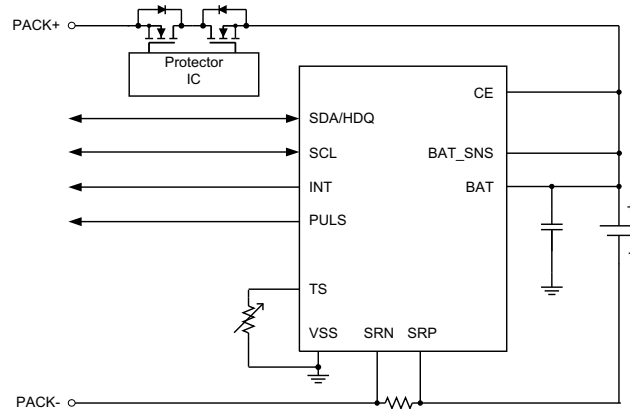
德州仪器 (TI) BQ27Z561 Impedance Track™ 电量监测计解决方案是一个高度集成且精确的单节串联电池电量监测计，具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和 SHA-256 认证，适用于锂离子和锂聚合物电池包。单节电池包括并联电芯，可提高容量。

BQ27Z561 电量监测计通过 I²C 兼容接口和 HDQ 单线接口进行通信，并具有几个有助于实现准确电量监测应用的关键功能。通过集成的温度检测功能 (内部和外部选项)，可实现系统和电池温度测量。集成的 SHA-256 功能有助于在系统和电池包之间实现安全识别。中断功能有助于 BQ27Z561 器件在发生充电状态 (SOC)，电压或温度故障时通知系统。通过低压运行，即使在深度放电的情况下，系统也能够继续监控电池。在低活动状态下，该器件可设置为低功耗库仑计数 (CC) 模式，从而允许该器件继续库仑计数，同时显著降低工作电流。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
BQ27Z561	DSBGA (YPH, 12)	1.69mm × 2.07mm

- (1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
- (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



简化版原理图



内容

1 特性	1	5.19 I ² C 时序 - 400kHz.....	8
2 应用	1	5.20 HDQ 时序.....	8
3 说明	1	5.21 典型特性.....	10
4 引脚配置和功能	3	6 详细说明	11
5 规格	4	6.1 概述.....	11
5.1 绝对最大额定值.....	4	6.2 功能方框图.....	11
5.2 ESD 等级.....	4	6.3 特性说明.....	11
5.3 建议运行条件.....	4	6.4 器件功能模式.....	13
5.4 热性能信息.....	5	7 应用和实施	15
5.5 电源电流.....	5	7.1 应用信息.....	15
5.6 内部 1.8V LDO (REG18).....	5	7.2 典型应用.....	15
5.7 I/O (PULS , INT)	5	7.3 电源要求.....	17
5.8 芯片使能 (CE).....	5	7.4 布局.....	17
5.9 内部温度传感器.....	6	8 器件和文档支持	19
5.10 NTC 热敏电阻测量支持.....	6	8.1 器件支持.....	19
5.11 库仑计 (CC).....	6	8.2 文档支持.....	19
5.12 模数转换器 (ADC).....	6	8.3 接收文档更新通知.....	19
5.13 内部振荡器规格.....	7	8.4 支持资源.....	19
5.14 电压基准 1 (REF1).....	7	8.5 商标.....	19
5.15 电压基准 2 (REF2).....	7	8.6 静电放电警告.....	19
5.16 闪存存储器.....	7	8.7 术语表.....	19
5.17 I ² C I/O.....	8	9 修订历史记录	19
5.18 I ² C 时序 - 100kHz.....	8	10 机械、封装和可订购信息	20

4 引脚配置和功能

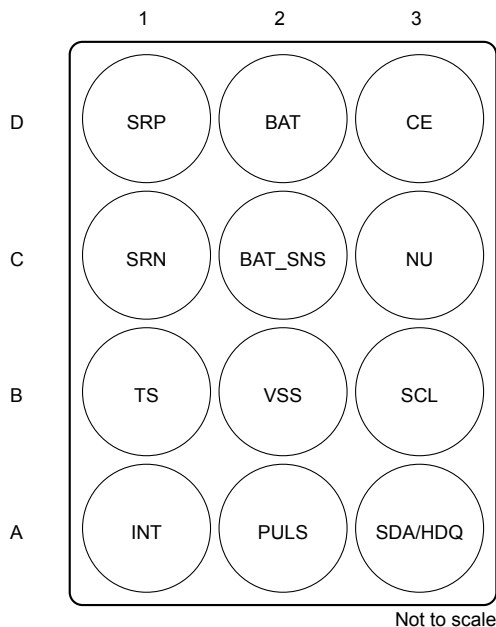


表 4-1. 引脚功能

编号	名称	类型 ⁽¹⁾	说明
D2	BAT	P	电池电压测量输入。开尔文电池检测与 BAT_SNS 的连接。在 BAT 和 VSS 之间连接一个电容器 (1μF)。将电容器放置在靠近测量仪表的位置。
D3	CE	I	高电平有效芯片使能
C2	BAT_SNS	AI	电池检测
A1	INT	O	电压、温度和充电状态中断 (可编程高电平或低电平有效)
A2	PULS	O	具有高电平有效或低电平有效选项的可编程脉冲宽度
B1	TS	AI	ADC 温度输入
C3	NU	NU	没有与外部电路连接
B3	SCL	I/O	I ² C 接口的串行时钟, 使用时需要外部上拉电阻。可以在未使用时保持悬空状态。
A3	SDA/HDQ	I/O	I ² C 接口的串行数据和用于 HDQ 的单线制接口 (可选), 使用时需要外部上拉电阻。可以在未使用时保持悬空状态。
D1	SRP	I	连接到内部库仑计数器外设的模拟输入引脚, 用于在 SRP (正极侧) 和 SRN 之间集成小电压
C1	SRN	I	连接到内部库仑计数器外设的模拟输入引脚, 用于在 SRP (正极侧) 和 SRN 之间集成小电压。
B2	VSS	P	器件接地

(1) P = 电源连接, O = 数字输出, AI = 模拟输入, I = 数字输入, I/O = 数字输入/输出, NU = 未使用

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
输入电压	BAT	-0.3	6	V
	INT、PULS、CE	-0.3	6	V
	SRP、SRN、BAT_SNS	-0.3	$V_{BAT} + 0.3$	V
	TS	-0.3	2.1	V
	SCL、SDA/HDQ	-0.3	6	V
工作环境温度, T_A		-40	85	°C
工作结温, T_J		-40	125	°C
贮存温度, T_{stg}		-65	150	°C

- (1) 在 **绝对最大额定值** 范围外运行可能对器件造成永久损坏。**绝对最大额定值** 并不表示器件在这些条件下或在 **建议的工作条件** 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 **建议运行条件** 但在 **绝对最大额定值** 范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

5.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$ 静电放电	所有引脚上的人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±1500	V
	所有引脚上的充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	±500	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 规定：500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

- (2) JEDEC 文档 JEP157 规定：250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

			最小值	标称值	最大值	单位
V_{BAT}	电源电压	无运行限制	2.0		5.5	V
C_{BAT}	从 BAT 到 VSS 的外部电容器		1			μF
V_{TS}	温度检测		0		1.8	V
V_{PULS} 、 V_{INT} 、 V_{CE}	输入和输出引脚		0		V_{BAT}	V
V_{SCL} 、 $V_{SDA/HDQ}$	通信引脚		0		V_{BAT}	V

5.4 热性能信息

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

热指标 ⁽¹⁾		BQ27Z561	单位
		DSBGA (YPH)	
		(12 引脚)	
R _{θJA}	结至环境热阻	64.1	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳（顶部）热阻	59.8	
R _{θJB}	结至电路板热阻	52.7	
ψ _{JT}	结至顶部特征参数	0.3	
ψ _{JB}	结至电路板特征参数	28.3	
R _{θJC(bot)}	结至外壳（底部）热阻	2.4	

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标应用手册](#)。

5.5 电源电流

除非另有说明，否则特性是在 T_A = -40°C 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{NORMAL}	标准运行条件		60		μA
I _{SLEEP}	检测电阻电流低于 SLEEP 模式阈值		11		μA
I _{DEEPSLEEP}	检测电阻电流低于 DEEP SLEEP 模式阈值		9		μA
I _{OFF}	CE = V _{IL}		0.5		μA

5.6 内部 1.8V LDO (REG18)

除非另有说明，否则特性是在 T_A = -40°C 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{REG18}	稳压器输出电压	1.6	1.8	2.0	V
V _{PORth}	POR 阈值	1.45		1.7	V
V _{PORhy}	POR 迟滞		0.1		V

5.7 I/O (PULS , INT)

除非另有说明，否则特性是在 T_A = -40°C 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	高电平输入电压	V _{REG18} = 1.8V	1.15		V
V _{IL}	低电平输入电压低	V _{REG18} = 1.8V		0.50	V
V _{OL}	输出电压低电平	V _{REG18} = 1.8V, I _{OL} = 1mA		0.4	V
C _i	输入电容		5		pF
I _{lkg}	输入漏电流			1	μA

5.8 芯片使能 (CE)

除非另有说明，否则特性是在 T_A = -40°C 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	高电平输入电压 ⁽¹⁾	V _{REG18} = 1.8V	0.75 × V _{BAT}		V
V _{IL}	低电平输入电压低 ⁽¹⁾	V _{REG18} = 1.8V		0.25 × V _{BAT}	V

(1) 根据设计确定

5.9 内部温度传感器

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{(\text{TEMP})}$ 内部温度传感器电压漂移	V_{TEMP}	1.65	1.73	1.8	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$
	$V_{\text{TEMP}} - V_{\text{TEMPN}}$ (通过设计确保)	0.17	0.18	0.19	

5.10 NTC 热敏电阻测量支持

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$R_{\text{NTRC(PU)}}$ 内部上拉电阻		14.4	18	21.6	$\text{k}\Omega$
$R_{\text{NTC(DRIFT)}}$ 电阻温漂		-250	-120	0	$\text{PPM}/^{\circ}\text{C}$

5.11 库仑计 (CC)

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{(\text{CC_IN})}$ 差分输入电压范围		-0.1		0.1	V
$t_{(\text{CC_CONV})}$ 转换时间	单次转换		1000		ms
有效分辨率	1LSB		3.8		μV
积分非线性	16 位, 输入电压范围最佳拟合	-22.3	5.2	+22.3	LSB
微分非线性	16 位, 无丢码		1.5		LSB
偏移误差	16 位, 校准后	-2.6	1.3	+2.6	LSB
失调电压误差漂移	15 位 + 符号, 校准后		0.04	0.07	$\text{LSB}/^{\circ}\text{C}$
增益误差	15 位 + 符号, 在输入电压范围内	-492	131	+492	LSB
增益误差温漂	15 位 + 符号, 在输入电压范围内		4.3	9.8	$\text{LSB}/^{\circ}\text{C}$
有效输入电阻		7			$\text{M}\Omega$

5.12 模数转换器 (ADC)

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{ADC_TS_GPIO}}$ 输入电压范围	$V_{\text{FS}} = V_{\text{REF2}}$	-0.2		1.0	V
	$V_{\text{FS}} = V_{\text{REG18}} \times 2$	-0.2		1.44	V
$V_{\text{BAT_MODE}}$ 电池输入电压		-0.2		5.5	V
积分非线性	16 位, 最佳拟合, -0.1V 至 $0.8 \times V_{\text{REF2}}$	-8.4		+8.4	LSB
微分非线性	16 位, 无丢码		1.5		LSB
偏移误差	16 位校准后 ⁽¹⁾ , $V_{\text{FS}} = V_{\text{REF2}}$	-4.2	1.8	+4.2	LSB
失调电压误差漂移	16 位校准后 ⁽¹⁾ , $V_{\text{FS}} = V_{\text{REF2}}$		0.02	0.1	$\text{LSB}/^{\circ}\text{C}$
增益误差	16 位, -0.1 至 $0.8 \times V_{\text{FS}}$	-492	131	+492	LSB
增益误差温漂	16 位, -0.1 至 $0.8 \times V_{\text{FS}}$		2	4.5	$\text{LSB}/^{\circ}\text{C}$
有效输入电阻		8			$\text{M}\Omega$
$t_{(\text{ADC_CONV})}$ 转换时间			11.7		ms
有效分辨率		14	15		位

(1) 工厂校准。

5.13 内部振荡器规格

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高频振荡器 (HFO)					
f_{HFO} 工作频率			16.78		MHz
f_{HFO} HFO 频率漂移	$T_A = -20^{\circ}\text{C}$ 至 70°C	-2.5%		2.5%	
	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C	-3.5		3.5	
t_{HFOSTART} HFO 启动时间	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C ，振荡器频率在标称频率的 $\pm 3\%$ 范围内或上电复位			4	ms
低频振荡器 (LFO)					
f_{LFO} 工作频率			65.536		kHz
$f_{\text{LFO(Err)}}$ 频率误差	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C	-2.5%		+2.5%	

5.14 电压基准 1 (REF1)

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REF1} 内部基准电压 ⁽¹⁾		1.195	1.21	1.227	V
$V_{\text{REF1_DRIFT}}$ 内部基准电压漂移	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C	-80		+80	PPM/C

(1) 用于 CC 和 LDO

5.15 电压基准 2 (REF2)

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REF2} 内部基准电压 ⁽¹⁾		1.2	1.21	1.22	V
$V_{\text{REF2_DRIFT}}$ 内部基准电压漂移	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C	-20		20	PPM/ $^{\circ}\text{C}$

(1) 用于 ADC

5.16 闪存存储器

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
数据保存时间		10	100		年
闪存编程写入周期数	数据闪存	20000			周期
	指令闪存	1000			周期
$t_{\text{(ROWPROG)}}$ 行编程时间				40	μs
$t_{\text{(MASSERASE)}}$ 批量擦除时间	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C			40	ms
$t_{\text{(PAGEERASE)}}$ 页擦除时间	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C			40	ms
$I_{\text{FLASHREAD}}$ 闪存读取电流	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C			1	mA
$I_{\text{FLASHWRTIE}}$ 闪存写入电流	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C			5	mA
$I_{\text{FLASHERASE}}$ 闪存擦除电流	$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C			15	mA

5.17 I²C I/O

除非另有说明，否则特性是在 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 85°C 的条件下记录的

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	高电平输入电压	SCL、SDA/HDQ、V _{REG18} = 1.8V	1.26			V
V _{IL}	低电平输入电压低	V _{REG18} = 1.8V	0.54			V
V _{OL}	低电平输出电压	I _{OL} = 1mA、V _{REG18} = 1.8V	0.36			V
C _I	输入电容		10			pF
I _{lkg}	输入漏电流		1			μA

5.18 I²C 时序 - 100kHz

参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
f _{SCL}	时钟工作频率	SCL 占空比 = 50%100			kHz
t _{HD:STA}	START 条件保持时间	4.0			μs
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	4.7			μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	4.0			μs
t _{SU:STA}	建立重复启动	4.7			μs
t _{HD:DAT}	数据保持时间 (SDA 输入)	0			ns
t _{SU:DAT}	数据设置时间 (SDA 输入)	250			ns
t _r	时钟上升时间	10% 至 90%1000			ns
t _f	时钟下降时间	90% 至 10%300			ns
t _{SU:STO}	建立时间停止条件	4.0			μs
t _{BUF}	停止和启动之间的总线空闲时间	4.7			μs

5.19 I²C 时序 - 400kHz

参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位	
f _{SCL}	时钟工作频率	SCL 占空比 = 50%			400	kHz
t _{HD:STA}	START 条件保持时间				0.6	μs
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期				1.3	μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期				600	ns
t _{SU:STA}	建立重复启动				600	ns
t _{HD:DAT}	数据保持时间 (SDA 输入)				0	ns
t _{SU:DAT}	数据设置时间 (SDA 输入)				100	ns
t _r	时钟上升时间	10% 至 90%			300	ns
t _f	时钟下降时间	90% 至 10%			300	ns
t _{SU:STO}	建立时间停止条件				0.6	μs
t _{BUF}	停止和启动之间的总线空闲时间				1.3	μs

5.20 HDQ 时序

参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位	
t _B	中断时间	190			μs	
t _{BR}	中断恢复时间	40			μs	
t _{HW1}	主机写入 1 次	主机驱动 HDQ		0.5	50	μs

参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
t_{HW0}	主机写入 0 次	86		145	μs
t_{CYCH}	主机到器件的周期时间	190			μs
t_{CYCD}	器件到主机的周期时间	190	205	250	μs
t_{DW1}	器件写入 1 次	32		50	μs
t_{DW0}	器件写入 0 次	80		145	μs
t_{RSPS}	器件响应时间	190		950	μs
t_{TRND}	主机周转时间	250			μs
t_{RISE}	HDQ 线上升到逻辑 1 的时间			1.8	μs
t_{RST}	HDQ 复位	2.2			s

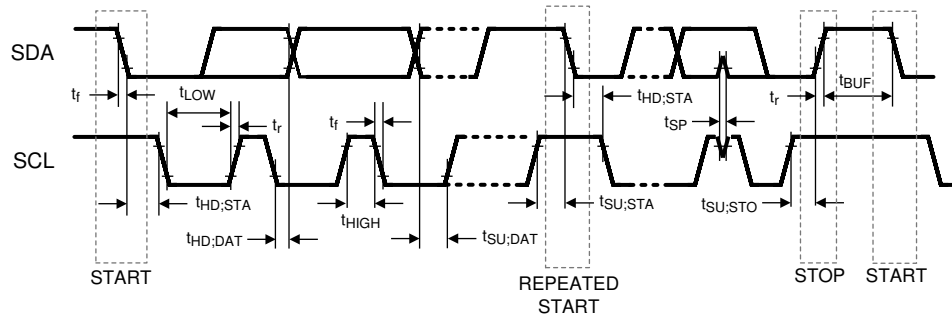
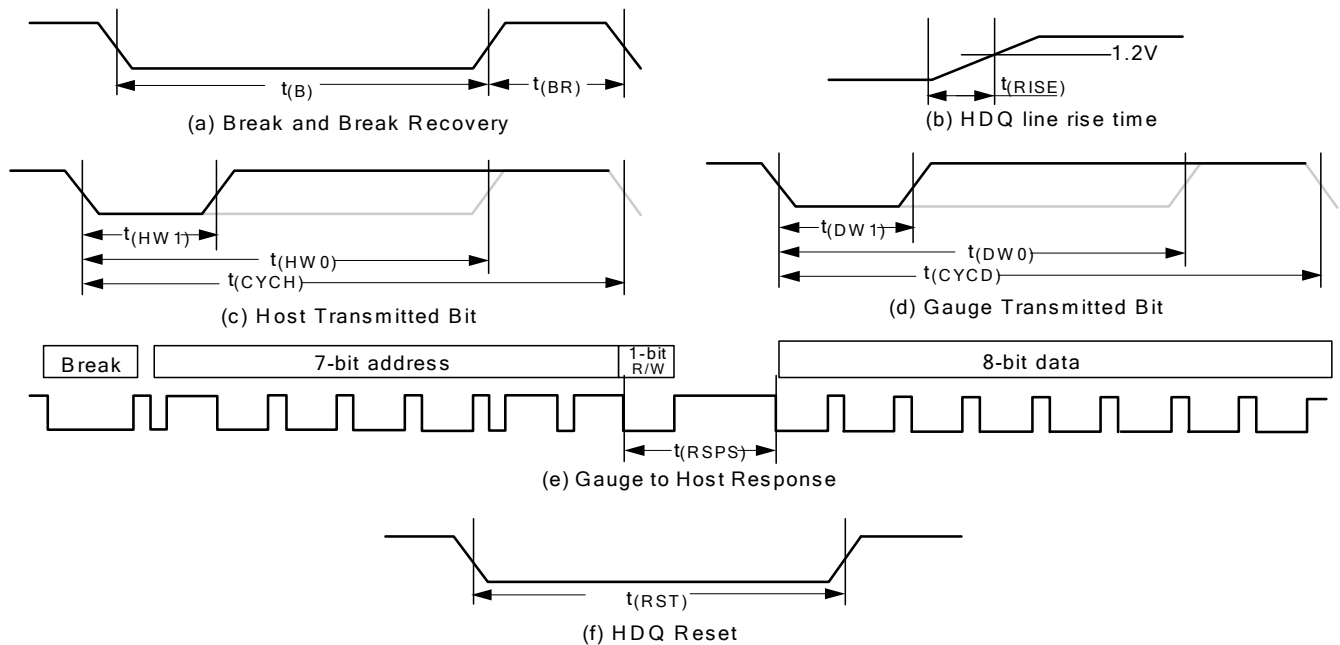


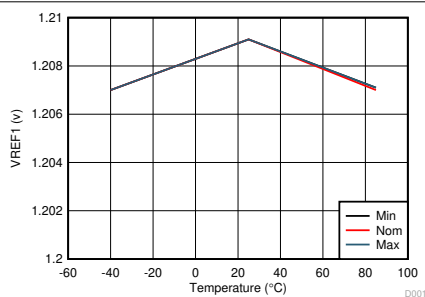
图 5-1. I²C 时序



- a. HDQ Breaking
- b. Rise time of HDQ line
- c. HDQ Host to fuel gauge communication
- d. Fuel gauge to Host communication
- e. Fuel gauge to Host response format
- f. HDQ Host to fuel gauge

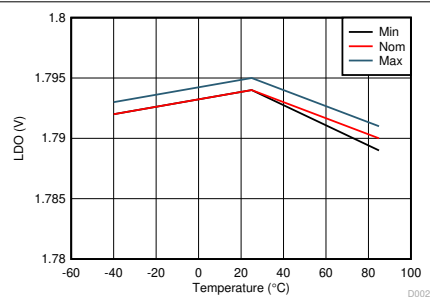
图 5-2. HDQ 时序

5.21 典型特性



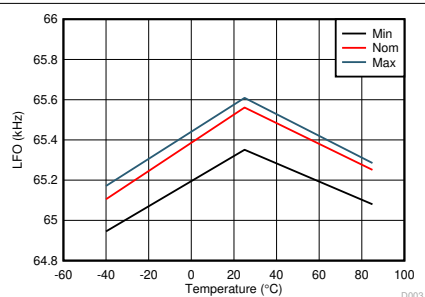
A. BAT 最小值 = 2V BAT 标称值 = 3.6V BAT 最大值 = 5V

图 5-3. REF1 电压与电池和温度之间的关系



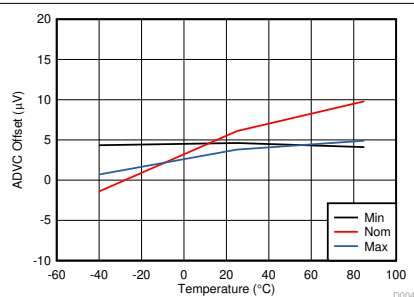
A. BAT 最小值 = 2V BAT 标称值 = 3.6V BAT 最大值 = 5V

图 5-4. LDO 电压与电池和温度之间的关系



A. BAT 最小值 = 2V BAT 标称值 = 3.6V BAT 最大值 = 5V

图 5-5. LFO 频率与电池和温度之间的关系



A. BAT 最小值 = 2V BAT 标称值 = 3.6V BAT 最大值 = 5V

图 5-6. ADVC 失调电压与电池和温度之间的关系

6.3.2.1 库仑计 (CC)

第一个 ADC 是一款集成式模数转换器，专为跟踪可充电电池的充电和放电活动或库仑计数而设计。首个 ADC 采用单通道差分输入，用于转换 SRP 和 SRN 端子之间检测电阻器两端的电压差，分辨率为 $3.74\mu\text{V}$ 。

6.3.2.2 CC 数字滤波器

CC 数字滤波器从 $\Delta-\Sigma$ CC 前端生成一个 16 位转换值。其 FIR 滤波器使用 HFO 时钟输出。每 1s 就有一次新的转换。

6.3.2.3 ADC 多路复用器

ADC 多路复用器提供到外部引脚 BAT、BAT_SNS、TS、内部温度传感器、内部基准电压、内部 1.8V 稳压器和 VSS 接地基准输入的可选连接。此外，多路复用器可以独立启用内部热敏电阻偏置电路的 TS 输入连接，并允许用户能够将多路复用器输入短路，以进行测试和校准。

6.3.2.4 模数转换器 (ADC)

第二个 ADC 是专为通用测量设计的 16 位 $\Delta-\Sigma$ 转换器。在采样过程中，ADC 会根据通道选择自动调节输入电压范围。转换器分辨率是其满标量程和位数的函数，产生的分辨率为 $38\mu\text{V}$ 。

6.3.2.5 内部温度传感器

BQ27Z561 器件上提供一个内部温度传感器，用于降低测量温度所需的外部元件的成本、功耗和尺寸。该传感器可以使用多路复用器连接到 ADC，经设计可在各种工作条件下快速确定电池包温度。

6.3.2.6 外部温度传感器支持

TS 输入由内部 $18\text{k}\Omega$ (典型值) 线性化上拉电阻启用，以支持使用 $10\text{k}\Omega$ (25°C) NTC 外部热敏电阻，例如 Semitec 103AT-2™。在 VSS 和单个 TS 引脚之间连接 NTC 热敏电阻。通过 ADC 输入多路复用器，使用 ADC 进行模拟量测量。如果需要不同类型的热敏电阻，则可能需要更改配置。

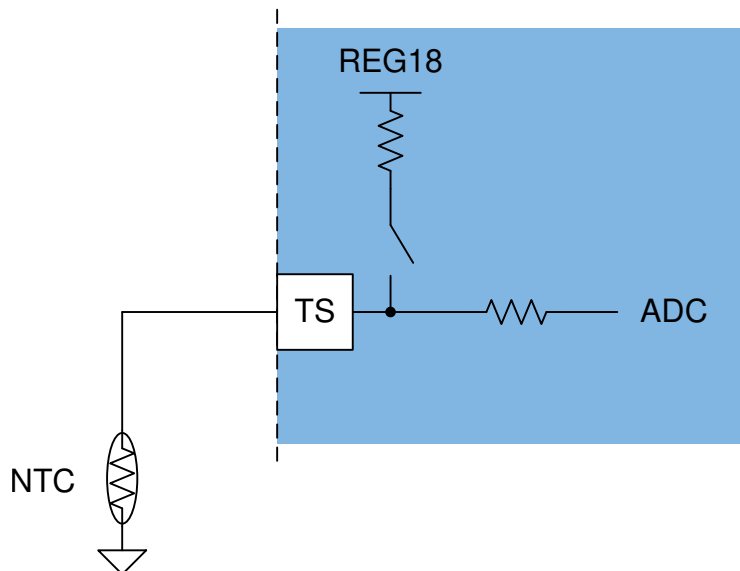


图 6-1. 外部热敏电阻偏置

6.3.3 电源控制

BQ27Z561 器件使用 BAT 引脚作为其电源。BAT 为内部电压源供电，从而为器件提供基准。BAT_SNS 是一个非载流路径，用于 BAT 的开尔文基准。

6.3.4 总线通信接口

BQ27Z561 器件有一个 I²C 总线通信接口。或者，可将 BQ27Z561 配置为通过 HDQ 引脚（与 SDA 共享）进行通信。

备注

器件切换到 HDQ 协议后，该开关就不可逆。

6.3.5 低频振荡器

BQ27Z561 器件包含一个以 65.536kHz 频率运行的低频振荡器 (LFO)。

6.3.6 高频振荡器

BQ27Z561 包括一个运行频率为 16.78MHz 的高频振荡器 (HFO)。HFO 的频率锁定到 LFO 输出，并以 50% 占空比缩小至 8.388MHz。

6.3.7 1.8V 低压降稳压器

BQ27Z561 器件包含一个集成的无电容器 1.8V LDO (REG18)，可为器件 CPU 和内部数字逻辑提供稳压电源电压。

6.3.8 内部基准电压

BQ27Z561 器件提供两个内部电压基准。REF1 由 REG18、振荡器和 CC 使用。REF2 由 ADC 使用。

6.3.9 Gas Gauging

该器件使用 Impedance Track™ 技术测量和确定电芯的可用电量。有关更多详细信息，请参阅 [Impedance Track 电池电量监测算法的理论及实现应用报告](#)。

6.3.10 充电控制特性

该器件支持充电控制特性，例如：

- 根据有效温度范围报告充电电压和充电电流 - JEITA 温度范围 T1、T2、T3、T4、T5 和 T6
- 提供更复杂的充电曲线，包括标准温度范围内的子范围
- 使用总线通信接口报告恒流充电所需的适当充电电流以及为智能充电器进行恒压充电所需的适当充电电压
- 使用 Impedance Track 方法选择每个电芯的化学充电状态
- 报告充电故障并通过充电和放电警报指示充电状态

6.3.11 身份验证

该器件借助以下特性确保安全，可在需要时启用这些特性：

- 主机使用 SHA-256 方法进行身份验证
- 电量监测计需要通过 SHA-256 认证，然后器件才能解封或允许完全访问。

6.4 器件功能模式

该器件支持四种模式，但根据特定功能的固件控制和运行模式，电流消耗会有所不同：

- **NORMAL 模式**：在此模式下，器件以 250ms 的间隔执行测量、计算、保护和数据更新。在这些间隔之间，该器件在更低的功率级下运行，以尽可能减少总平均电流消耗。
- **SLEEP 模式**：在此模式下，器件以可调节的时间间隔执行测量、计算和数据更新。在这些间隔之间，该器件在更低的功率级下运行，以尽可能减少总平均电流消耗。
- **DEEP SLEEP 模式**：在此模式下，电流会略有减少，同时仍会定期测量电流和电压，并以用户定义的读取间隔时间进行测量。
- **OFF 模式**：通过拉低 CE 可以完全禁用该器件。CE 禁用内部电压轨。所有非易失性存储器都不受保护。

6.4.1 终身记录特性

该器件支持对多个关键参数进行数据记录，以供保修和分析之用：

- 最高和最低电芯温度
- 充电或放电模式下的最大电流
- 最大和最小电芯电压

6.4.2 配置

该器件支持对多个关键参数进行精确的数据测量和数据记录。

6.4.2.1 以库仑为单位计

该器件使用集成式 Δ - Σ 模数转换器 (ADC) 进行电流测量。ADC 通过测量超小外部检测电阻两端的电压来测量电池的充放电电流。积分 ADC 测量 -100mV 至 100mV 范围内的双极信号， $V_{(SRP)} - V_{(SRN)}$ 为正值时表示充电电流，为负值时表示放电电流。

系统通过测量外部检测电阻（可低至 $1\text{m}\Omega$ ）两端的压降来执行电流测量，并根据差分电压的极性确定电芯的充电或放电模式。

6.4.2.2 电池电压测量

BQ27Z561 电量监测计使用 ADC 以 1s 的间隔测量电芯电压。该电压测量值在内部针对 ADC 进行缩放并进行校准以减少偏移导致的任何误差。该数据还用于计算 Impedance Track 电量监测的电芯阻抗。

6.4.2.3 自动校准

自动校准功能有助于消除 SRP 和 SRN 引脚上的任何电压偏移，从而准确测量电芯电压、充电/放电电流和热敏电阻温度。当总线上至少 5s 没有通信活动时，将执行自动校准。

6.4.2.4 温度测量

该器件具有一个用于片上温度测量的内部传感器，能够通过 TS 引脚上的外部 NTC 支持外部温度测量。这两个测量值可分别启用和配置。

备注

7.1 应用信息

7.2 典型应用

The schematic diagram illustrates the battery protection circuit for the BQ76940 IC. The IC is connected to the PACK+ and PACK- terminals. The PACK+ terminal is connected to the CE pin of the IC and the positive terminal of the battery. The PACK- terminal is connected to the VSS pin of the IC and the negative terminal of the battery. The IC's SDA/HDQ, SCL, INT, and PULS pins are connected to the microcontroller. The BAT_SNS pin is connected to the positive terminal of the battery. The BAT pin is connected to the positive terminal of the battery and a 1 μF capacitor. The TS pin is connected to a 10 kΩ thermistor. The SRN and SRP pins are connected to a sense resistor network consisting of R_{SRN} (100 Ω), R_{SENSE} (1 mΩ), and R_{SRP} (100 Ω). A 0.1 μF capacitor is connected between the SRN and SRP pins. The VSS pin is connected to ground.

图 7-1. BQ27Z561 1 节串联电芯典型实现方式

7.2.1 设计要求 (默认)

设计参数	示例
电芯配置	1s1p (1 串 1 并)
设计容量	5300mAh
器件化学成分	锂离子电池
设计电压	4000mV
电芯低电压	2500mV

7.2.2 详细设计过程

7.2.2.1 更改设计参数

有关设计要求所需的固件设置，请参见 [BQ27Z561 技术参考手册](#)。

- 要更改设计容量，请在 **Gas Gauging: Design: Design Capacity** 寄存器中设置数据闪存值 (以 mAh 为单位)。
- 要设置器件化学成分，请转至数据闪存 **I²C Configuration: Data: Device Chemistry**。bqStudio 软件会自动填充正确的化学成分标识。此选择是使用工具中的 bqCHEM 功能以及从列表中选择与器件化学成分匹配的选项得出的。
- 要设置设计电压，请转至 **Gas Gauging: Design: Design Voltage** 寄存器。
- 要设置电池 **Low Voltage** 或清除电池 **Low Voltage**，请使用 **Settings: Configuration: Init Voltage Low Set** 或 **Clear**。这用于设置电芯电压电平，该电压电平将设置 (清除) **Interrupt Status** 寄存器中的 [VOLT_LO] 位。
- 要启用内部温度和外部温度传感器，请：设置 **Settings: Configuration: Temperature Enable**：对于内部传感器，位 0 (TSInt) = 1；对于外部传感器，位 1 (TS1) = 1。

7.2.3 校准过程

通过将 0xF081 或 0xF082 写入 **ManufacturerAccess()**，可以校准电流、电压和温度读数。[BQ27Z561 技术参考手册](#) 的 **校准** 部分包含详细过程。该描述允许校准电芯电压测量偏移、电池电压、电流校准、库仑计数器偏移、PCB 偏移、CC 增益/容量增益以及内部和外部传感器的温度测量。

7.2.4 监测数据更新

当一个被 BQ27Z561 电量监测计启用的电池包循环时，**FullChargeCapacity()** 的值会更新数次，包括充电或放电开始、充电终止、温度差值、放电期间的电阻值更新以及弛豫。[图 7-2](#) 显示了当其中一些更新在单个应用周期内发生时的实际电芯电压、负载电流和 **FullChargeCapacity()**。

图中的更新点包括：

- 7900s 时充电终止
- 9900s 时弛豫
- 11500s 时电阻更新

7.2.4.1 应用曲线

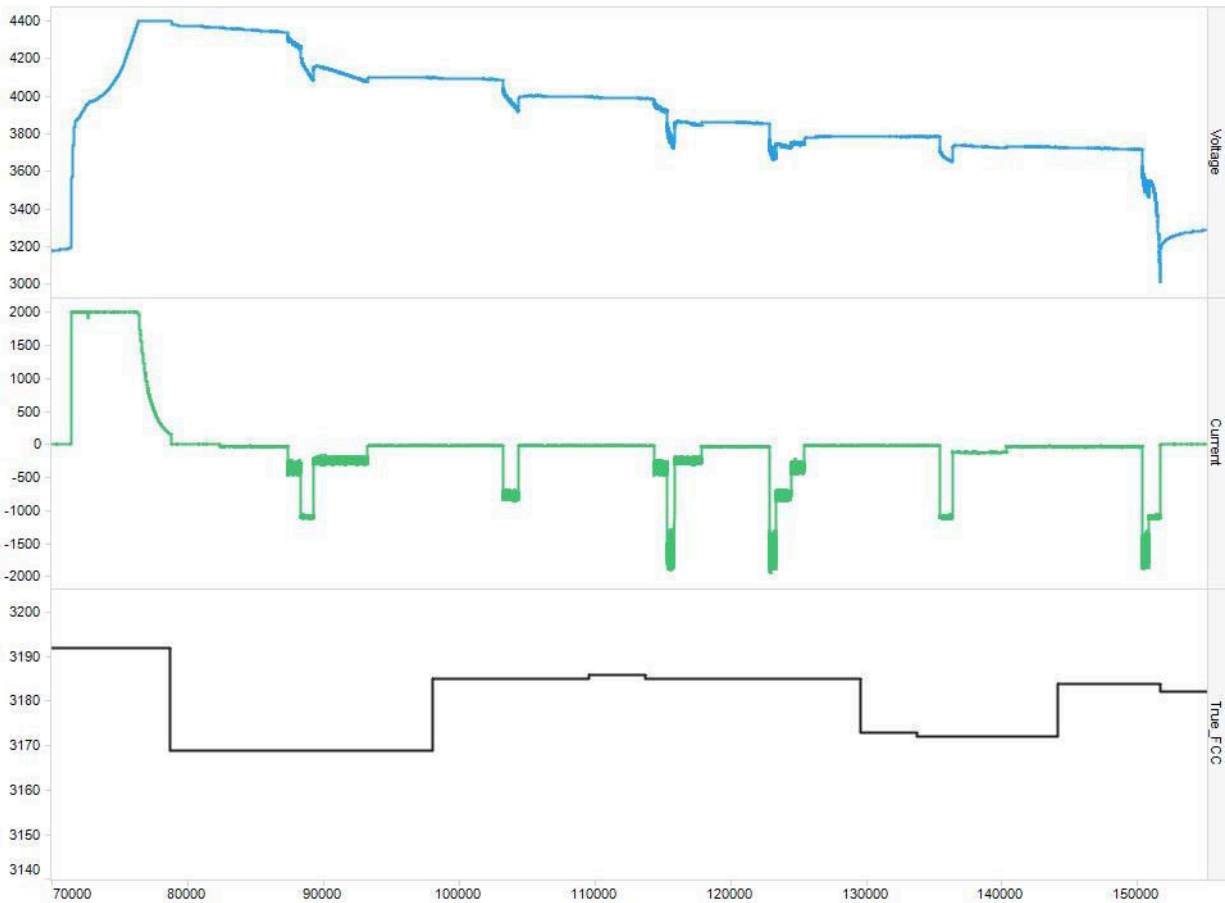


图 7-2. 充满电容量跟踪 (X 轴为秒)

7.3 电源要求

唯一电源是连接到电池正极端子的 BAT 引脚。BAT 引脚的输入电压最小为 2V，最大为 5V。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

- 检测电阻上的开尔文连接质量至关重要。确认检测电阻的温度系数不大于 50ppm，以更大程度地减小电流测量随温度的漂移。选择检测电阻的值，使其与 BQ27Z561 电量监测计可用的过流和短路范围相对应。选择尽可能小的值，以便更大限度地减小短路期间 BQ27Z561 VSS 节点上产生的负电压。该引脚的绝对最小值为 -0.3V。只要建立了良好的开尔文检测，就使用并联电阻。该器件的设计支持 1mΩ 至 3mΩ 检测电阻。
- 直接将 BAT_SNS 连接到电池的正极。确认 BAT_SNS 显示不与 BAT 引脚共享路径。
- 对于电量监测计电路，差分低通滤波器和 I²C 通信在元件放置和布局时需重点关注。
- BQ27Z561 电量监测计使用一个积分 Δ - Σ ADC 来测量电流。在检测电阻与器件的 SRP 和 SRN 输入之间添加一个 100Ω 电阻器。在 SRP 和 SRN 输入端放置一个 0.1μF 滤波电容器。如果电路需要，可以添加 0.1μF 滤波电容器，为每个接地检测输入引脚进行额外的噪声滤波。所有滤波器元件尽可能靠近器件放置。从检测电阻到滤波器电路的布线应并联。在滤波器网络周围添加接地平面以提供额外的抗噪能力。
- BQ27Z561 具有一个内部 LDO，该 LDO 经过内部补偿，不需要外部去耦电容器。
- I²C 时钟和数据引脚具有集成式高压 ESD 保护电路；但是，添加齐纳二极管和串联电阻器可提供更强大的 ESD 性能。I²C 时钟和数据线具有内部下拉电阻。当电量监测计检测到两条线路都为低电平时（例如在取出电池包期间），该器件会执行自动偏移校准，然后进入 SLEEP 模式以节省电量。

7.4.2 布局示例

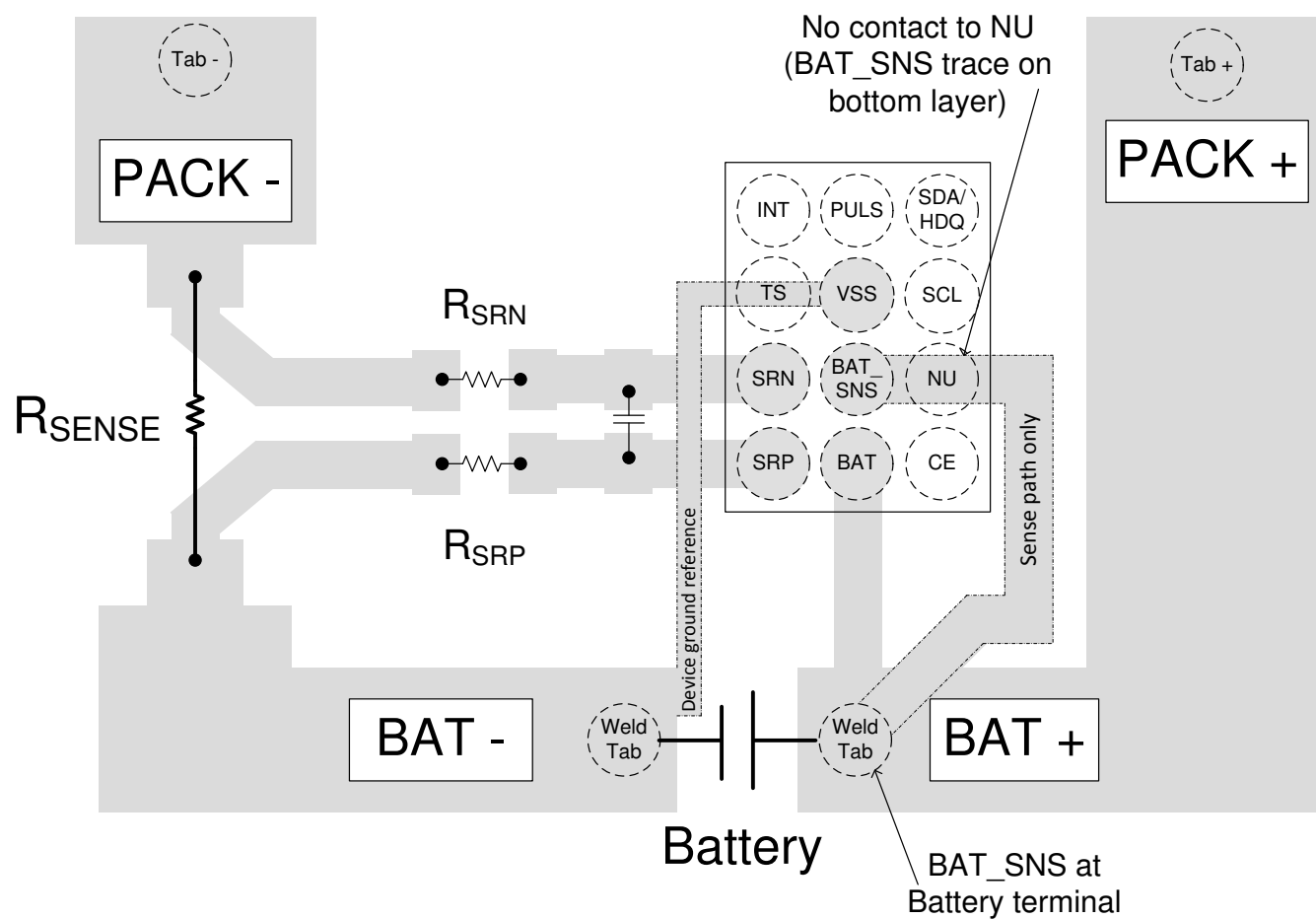


图 7-3. BQ27Z561 主要布线电路板布局布线

8 器件和文档支持

8.1 器件支持

8.1.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

8.2 文档支持

8.2.1 相关文档

- 德州仪器 (TI)，[BQ27Z561 技术参考手册](#)
- 德州仪器 (TI)，[BQSTUDIO 软件](#)
- 德州仪器 (TI)，[bq2750x 系列中 Impedance Track™ 电池电量监测算法的理论及实现应用手册](#)

8.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击右上角的 **通知我** 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.4 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

8.5 商标

Impedance Track™ and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

Semitec 103AT-2™ is a trademark of SEMITEC Corporation.

所有商标均为其各自所有者的财产。

8.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.7 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision B (October 2022) to Revision C (September 2025)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
• 删除了 “I/O” 部分中的 CE 参考.....	5
• 从输入电压范围：差分输入电压范围.....	6

Changes from Revision A (August 2019) to Revision B (October 2022)	Page
• 更改了 器件信息 中的封装尺寸.....	1

- 添加了芯片使能 (CE) 部分，其中包含为通过设计确定的 CE 引脚阈值..... 5
-

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
BQ27Z561YPHR	Active	Production	DSBGA (YPH) 12	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BQ27Z561
BQ27Z561YPHR.A	Active	Production	DSBGA (YPH) 12	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BQ27Z561
BQ27Z561YPHR.B	Active	Production	DSBGA (YPH) 12	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BQ27Z561
BQ27Z561YPHT	Active	Production	DSBGA (YPH) 12	250 SMALL T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BQ27Z561
BQ27Z561YPHT.A	Active	Production	DSBGA (YPH) 12	250 SMALL T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BQ27Z561
BQ27Z561YPHT.B	Active	Production	DSBGA (YPH) 12	250 SMALL T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BQ27Z561

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

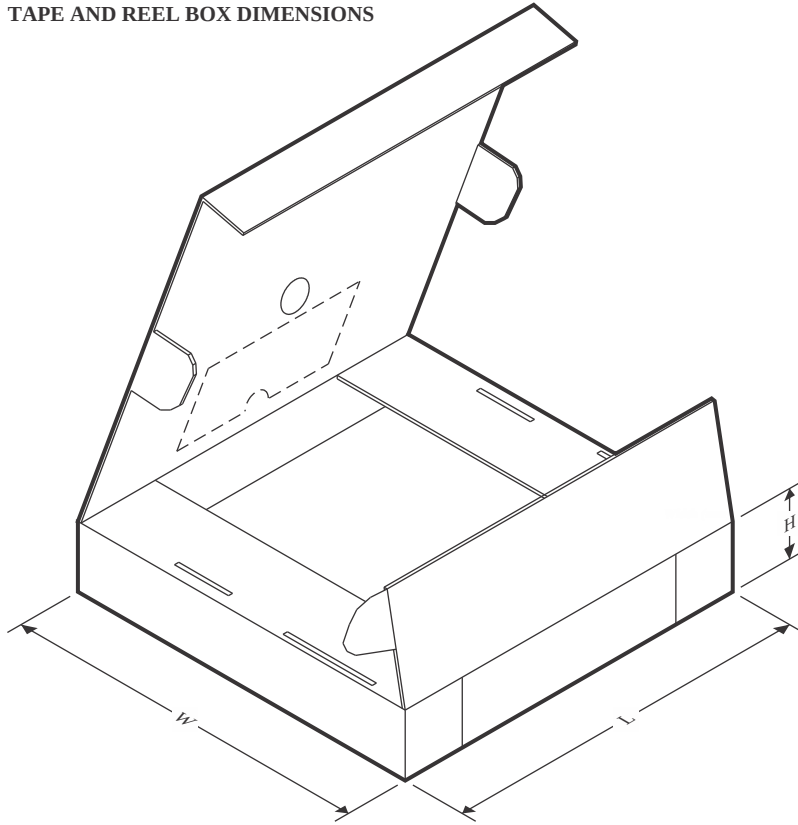
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

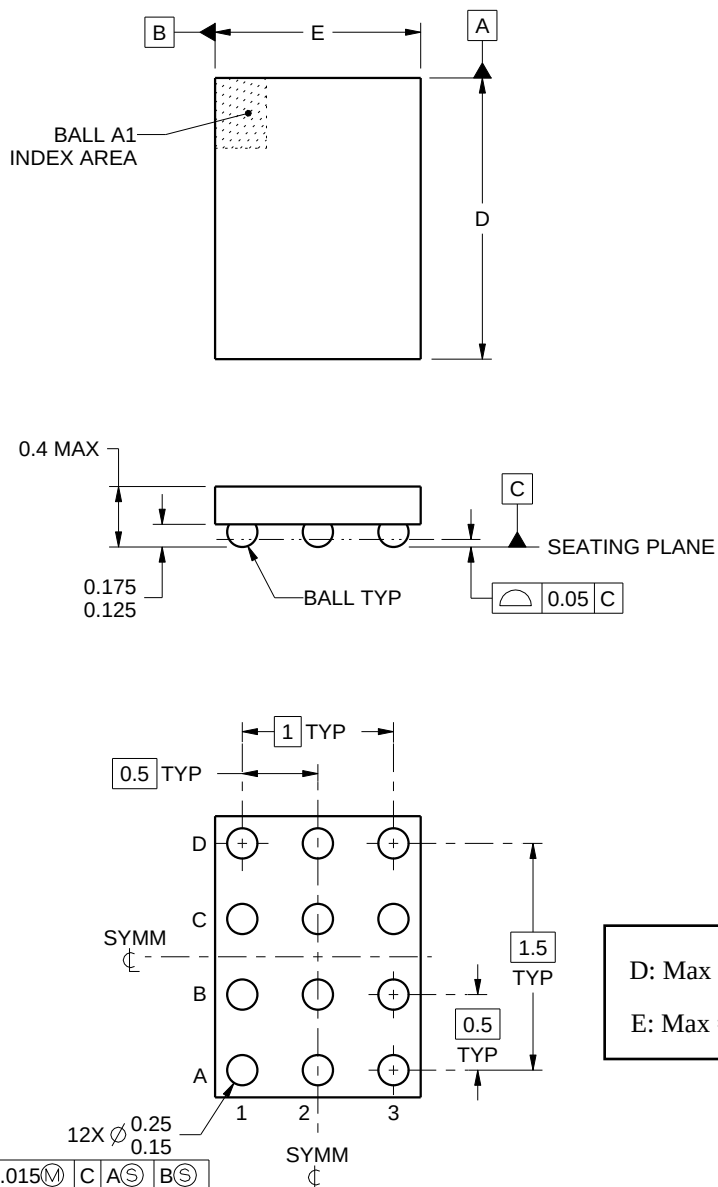
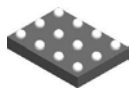
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
BQ27Z561YPHR	DSBGA	YPH	12	3000	180.0	8.4	1.83	2.2	0.53	4.0	8.0	Q1
BQ27Z561YPHT	DSBGA	YPH	12	250	180.0	8.4	1.83	2.2	0.53	4.0	8.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
BQ27Z561YPHR	DSBGA	YPH	12	3000	182.0	182.0	20.0
BQ27Z561YPHT	DSBGA	YPH	12	250	182.0	182.0	20.0



4222640/A 12/2015

NOTES:

NanoFree Is a trademark of Texas Instruments.

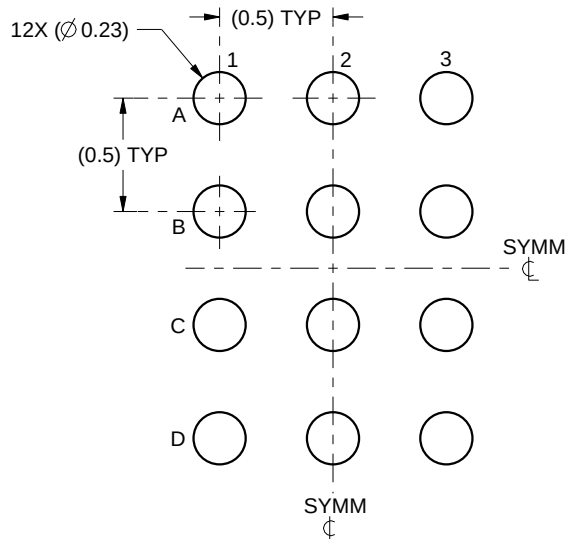
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. NanoFree™ package configuration.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

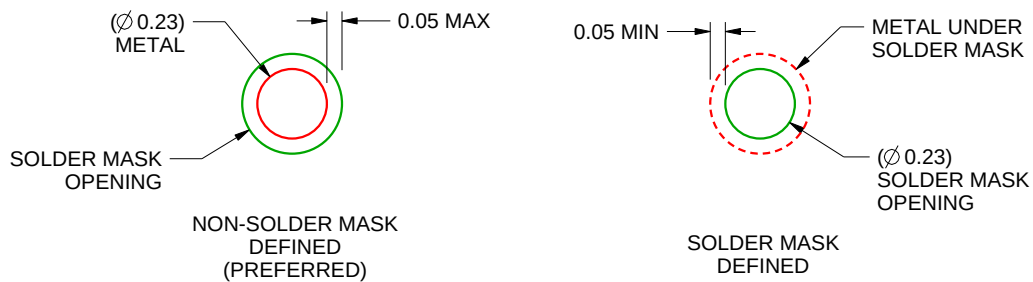
YPH0012

DSBGA - 0.4 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:30X

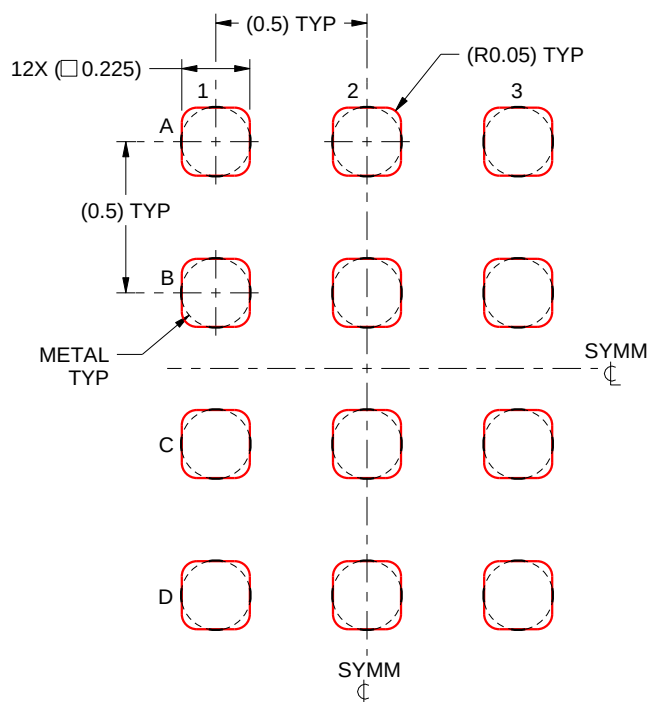


SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4222640/A 12/2015

NOTES: (continued)

- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).



SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
 SCALE:40X

4222640/A 12/2015

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月